

《科创板日报》3月3日讯（记者敖瑾）小米100亿元智能制造产业基金又有新进展。

金山软件2日在港交所公告，公司附属公司武汉金山、小米北京、小米武汉等，与其他投资者订立合伙协议，内容有关成立集成电路相关领域股权投资基金，预期总规模100亿元。

除了小米和金山外，该基金LP还包括北京市引导基金、亦庄国际投资等国资平台，以及北京兆易、帝奥微等产业方。该基金执事合伙人为小米北京。

金山软件投资者关系人士对《科创板日报》记者表示，金山软件作为有限合伙人参与，并未涉及基金的运营层面，“是财务投资，主要想把账面上的现金更好地使用起来。”

有半导体行业人士对记者表示，该基金囊括了多个产业相关方，对产业生态的构建和引领有实质性的助推作用，“毕竟它们懂产业，同时既是供给方，更是需求方。”

小米关联方与北京国资联手打造

据金山软件的公告，该支基金将主要着重于集成电路，以及相关上游及下游领域，涵盖新一代信息科技、智能制造、新材料、人工智能、显示器及显示装置、汽车电子，以及有关移动终端消费品、智能装置的上游及下游应用及供应链。

对于出资该基金的目的，金山软件在公告中称，基金投资于符合国家创新驱动发展、产业转型趋势的行业，可令公司资产配置结构持续优化，且预期可以获得较好的资金回报，提高资金使用效率。

除小米和金山外，该基金的LP还包括北京市引导基金、亦庄国际投资等国资平台，以及北京兆易、帝奥微以及纳星创投等产业投资方。其中，LP中出资数额最大的为小米武汉，出资30亿元；其次为北京市引导基金、亦庄国际投资以及天津海创，分别出资20亿元、10亿元、10亿元。